

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于 2020 年度日常关联交易执行情况 及 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“晶方科技”）发生的日常关联交易均遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本次日常关联交易预计事项经公司审计委员会审核并发表书面意见：2021年度公司日常关联交易预计事项遵循了公平的交易原则和公允的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形形成依赖。上述书面意见提交公司董事会审议，并向公司监事会报告。

2021年4月25日，公司召开第三届董事会三十次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

独立董事对上述日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表独立意见，认为本次日常关联交易为公司正常生产经营所必须发生的，预计合理，定价公允，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平合理的定价原则，不会损害公司和股东的利益；表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规

定，同意本次日常关联交易预计事项。

公司监事会经审核后认为：公司2021年预计发生的日常关联交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场经营规则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2021年日常关联交易的预计事项。

（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

2020年4月27日，公司召开第三届董事会十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事刘洋先生予以回避表决。

预计2020年度发生的日常关联交易总金额合计不超过人民币500万元（含税），具体情况如下：

关联人	交易类别	2021年预计发生金额 (含税)	2020年全年 交易金额（含 税）	差异原因
苏州晶方半导体科技 股份有限公司	购买原材料	不超过人民币300万元	1,917,635.38元	委托购买量减少
	委托关联方加工	不超过人民币200万元	292,321.47元	委托加工量减少

（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别

预计2021年度发生的日常关联交易总金额不超过人民币100万元（含税），具体情况如下：

关联人	交易类别	2021年预计发生金额（含税）
苏州晶方半导体科技股份有限公司	委托关联方加工（含原 材料）	不超过人民币100万元

二、 关联方和关联关系介绍

（一）关联方的基本情况

公司名称：苏州晶方半导体科技股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市公司）

注册地址：苏州工业园区汀兰巷29号

法定代表人：王蔚

注册资本：33,934.4764万元

主营业务：晶方科技主要专注于传感器领域的封装测试业务，封装产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片等，该等产品广泛应用在手机、安防监控、身份识别、汽车电子、3D 传感等电子领域。

主要财务指标：截至2020年12月31日，晶方科技的总资产为人民币3,733,560,121.10元，净资产为人民币3,364,464,020.49元，2020年度营业收入为人民币1,103,528,757.63元，净利润为人民币381,616,747.13元（经审计）。

（二）关联关系

本公司关联自然人刘洋先生自2020年3月20日至2021年1月4日期间担任公司非独立董事，同时，刘洋先生自2019年6月14日至2020年12月23日期间担任晶方科技非独立董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款及第10.1.7条的规定，自2020年3月20日至2021年12月23日期间，公司与晶方科技形成关联关系。

（三）履约能力分析

晶方科技依法存续，经营情况和财务状况正常，具有良好的履约能力，日常交易中能够遵守合同约定，不会对交易双方的生产经营带来风险。

三、 关联交易主要内容和定价政策

晶方科技作为公司的供应商，公司委托其进行晶圆级封装加工（含原材料）。公司与晶方科技之间的日常关联交易为生产经营所需，定价政策是根据公允原则并参考市场价格由双方协商确定，不存在影响公司持续经营能力及损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

公司（甲方）与晶方科技（乙方）于 2016 年 8 月 5 日签署《晶圆级封装加工协议》，就晶圆或集成电路（下称“制成品”）的封装加工规范要求、结算方式及期限等事项进行约定：

1、该协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为 1 年，如协议届满前 30 日，任何一方未以书面通知对方协议期满终止，则协议自动延期，每次延期 1 年。

2、制成品单价由乙方提供各个型号产品正式报价单为准，双方签署确认。结算方式为月结 60 天甲方自收到乙方开具合法发票后将上个月对帐确认的制成品的封装加工费用支付至乙方指定账户。

3、乙方提供给甲方制成品的品质，应符合国际标准、中华人民共和国国家标准及行业标准，同时满足双方协定的其它标准。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司与晶方科技一直保持正常的经营业务往来关系，发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，相关交易符合公司实际情况。交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司发展，不存在损害公司利益以及中小股东利益的情形。该日常关联交易不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

五、 备查文件

- （一）第三届董事会第三十次会议决议；
- （二）第三届监事会第二十七次会议决议；
- （三）独立董事关于预计 2021 年度日常关联交易事项的事前认可意见；
- （四）独立董事对关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
- （五）审计委员会关于预计 2021 年度日常关联交易事项的书面意见。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

